

# 3D&UVソリューションフェア in Spring

会場：Roland DG 東京クリエイティブセンター

参加セミナーにチェック/必要事項をご記入の上FAXでお申込みください。

<開催日> 2018  
4/12-13  
(木-金)

それぞれの業種に特化した商社様やユーザー様をお招きし、最新トレンドや活用術、商材をヒントに新たなビジネスへの展開やさらなる現状の効率化などについて各種セミナーを開催いたします。各社12-13日両日通して出展します。セミナーに出席できない場合も個別にご案内可能です。皆様のビジネス発展のヒントにお役立ていただき、他業種の方々との情報交換をお楽しみください。

## ■4月12日(木)実施セミナー

10:00～ 株式会社マクロス

注目度No.1！話題のクラウドベース3DCAD/CAM FUSION 360のご紹介

AUTODESK社が提供しているクラウドベースの3DCAD/CAMソフト「FUSION 360」の卓越した機能と操作性を解説します。今回はCAM機能についても活用事例を交えて詳しく紹介いたしますので、設計から加工までの一連のワークフローを体感いただけます。

11:00～ 株式会社大王製作所

すぐに使えるプリント用グッズ材料のご紹介 ★抽選会あり

UVプリンターで検討時に一番質問が多い「材料」についてご紹介するセミナーです。材料を沢山取り揃えてご紹介いたします。ご参加者全員に、UVプリントできる印刷商材・加工パーツが当たる引換券もお渡しいたします。

13:00～ ユニオンツール株式会社

切削工具の選定セミナー

エンドミル加工の基礎や、工具についてのセミナー。一般的な材料(鉄鋼材～樹脂まで)に加え、従来までは切削加工が不可能だった超硬合金、硬脆材の加工が可能な工具の紹介です。工具形状、加工の基礎を中心に、最新の加工まで幅広く紹介させていただきます。

14:00～ コムネット株式会社

業務の「見える化」を狙う！導入事例を交えたソフトウェアご紹介セミナー

ソフトウェアだからこそできる「時短」や業務の「見える化」に興味は御座いませんか？コムネットはものづくりをハードウェアとソフトウェアでサポート致します。IT補助金の活用例と併せて、弊社ソフトウェアの導入事例をご紹介致します。

15:00～ ロ-ランド ディー.ジー.株式会社

新製品のご案内 ～半導体レーザー箔転写機と B to C向け提案～

UVプリンターから新製品の半導体レーザー箔転写機まで当社の製品を活用したソリューションをご提案します。さらに、B to C向けに小ロット提案を行うためのご提案もいたします。

## ■4月13日(金)実施セミナー

10:00～ 株式会社システムクリエイト

3Dスキャナーを活用した印刷用治具の作成セミナー

取り扱い3Dスキャナーの活用事例をはじめ効率的な使い方やスキャン時のノウハウなどをUVプリンターでの印刷用治具をモデルにご紹介します。3Dスキャンデータはリバースエンジニアリングと呼ばれるような設計データとしての活用はもちろん品質証明やプレゼン資料など様々な活用方法があります。「一度3Dスキャンを試してみたかった!」「新たな取組にチャレンジしてみたかった!」というお客様、ぜひこの機会に参加ください。

11:00～ 株式会社木商

切削用素材の世界

切削用素材別の色調の違い、厚みのバリエーション、加工性などをご説明いたします。また用途別の最適な材料のご案内もさせていただきます。

13:00～ 株式会社プロモ

全自動ポッピング加工による高付加価値シールラベル・オリジナルグッズ提案

ポッピングは主剤と硬化剤を化学反応させたポリウレタン樹脂を、商品にドーム状に塗布し硬化させる加工です。プロモでは自社開発の全自動ポッピングマシンPro1-4020を使用して、小ロットから短納期大量製作まで高品質なポッピング加工の請負から、全自動ポッピングマシンの販売まで一貫したサービスを行っています。他にないシールラベル・オリジナルグッズに関心のある方、新たなビジネスとしてチャレンジしたい方、是非ご参加ください。

14:00～ ユ-ロポート株式会社

幅広い素材にフルカラープリント！昇華転写でビジネスをはじめよう

昇華転写はポリエステル生地素材をはじめ、ポリエステル樹脂をプレコートしたマグカップや陶器・ガラスなどにプリントすることができます。色鮮やかにプリントでき、プリントしても素材の風合いを損なわず、伸縮に強いのが昇華プリントです。グッズやウェア作成に最適な昇華プリントの(ビジネスでの)活用方法についてご提案いたします。

15:00～ ロ-ランド ディー.ジー.株式会社

新製品のご案内 ～半導体レーザー箔転写機と B to C向け提案～

お申込みは裏面へ→

# 3D&UVソリューションフェア in Spring

お申込  
ファックス番号



**FAX.03-5733-4412**

**E-mail**

rdg-tky@rolanddg.co.jp

必要事項をご記入の上、お申込ください。

ご参加予定のセミナーにチェックを入れてください。

## ■4月12日(木)

- 10:00～ 株式会社マクロス  
話題の3Dプリンター-3DCAD/CAM FUSION 360のご紹介
- 11:00～ 株式会社大王製作所  
すぐに使えるプリント用グッズ材料のご紹介
- 13:00～ ユニオンツール株式会社  
切削工具の選定セミナー
- 14:00～ コムネット株式会社  
業務の「見える化」を狙う！ソフトウェアご紹介セミナー
- 15:00～ ローランド ディー.ジー.株式会社  
新製品のご案内～半導体レーザー箔転写機と B to C向け提案～

## ■4月13日(金)

- 10:00～ 株式会社システムクリエイト  
3Dスキャナーを活用した印刷用治具の作成セミナー
- 11:00～ 株式会社木商  
切削用素材の世界
- 13:00～ 株式会社プロモ  
全自動ポッティング加工による高付加価値シールラベル・オリジナルグッズ提案
- 14:00～ ユーロポト株式会社  
幅広い素材にフルカラープリント！昇華転写でビジネスをはじめよう
- 15:00～ ローランド ディー.ジー.株式会社  
新製品のご案内～半導体レーザー箔転写機と B to C向け提案～

フリガナ		業 種	
会社名	※個人の方は記入不要です。		
フリガナ		所 属	
氏 名		E-mail	
フリガナ			
住 所	〒		
			※郵便番号は必ずご記入ください。
T E L		F A X	

■ご指定の販売店がある場合はご記入ください。

## ■ お問い合わせ先

**ローランド ディー.ジー.株式会社**

〒105-0013 東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル1F

**受付時間** 月曜日～金曜日 9時～17時

**TEL.03-5733-4410**

**E-mail** rdg-tky@rolanddg.co.jp

東京営業所 担当: 永森・横内



## ●プライバシーポリシーに関して(お客様の個人情報の利用目的等に関する同意)

当社は、お客様の個人情報を本内覧会の受付、連絡など運営に利用するほか、お客様への当社製品のご案内(DM)やサービス改善などの目的で利用します。また、利用目的に基づくサービスを充実させるため販売店等へ第三者提供を実施します。なお、お客様のご要望により第三者提供の停止を実施します。詳しくは、当社「プライバシーポリシー」に記載しております。ご確認の上、お申し込みください。  
(プライバシーポリシー: <https://www.rolanddg.co.jp/>) ご質問・訂正・利用停止などは下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

本内覧会の受付、連絡など運営以外の利用目的に  同意する  同意しない ※どちらにもチェックがない場合は同意するとみなして取り扱わせていただきます。